

杭州士兰微电子股份有限公司 对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 18 日与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府签署了《12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。同时，为落实前述《战略合作协议》，公司、公司全资子公司厦门士兰微电子有限公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司签署了《12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。

根据《战略合作协议》和《投资合作协议》，各方合作在厦门市海沧区合资经营项目公司“厦门士兰集华微电子有限公司（以下简称“士兰集华”）”，作为“12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目”的实施主体，建设一条 12 英寸集成电路芯片制造生产线，产品定位为高端模拟集成电路芯片。一期项目投资 100 亿元，其中资本金 60.10 亿元，建成后形成月产能 2 万片。

公司于 2025 年 10 月 18 日召开的第九届董事会第三次会议和 2025 年 12 月 8 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了上述事项，详见公司于 2025 年 10 月 20 日和 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号：临 2025-047、临 2025-048、临 2025-056）。

二、对外投资进展情况

士兰集华“12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目（一期）”已于近日取得《厦门市企业投资项目备案证明（内资）》（编号：厦海发投备〔2025〕858 号）。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日